



## VIA Technologies, Inc.

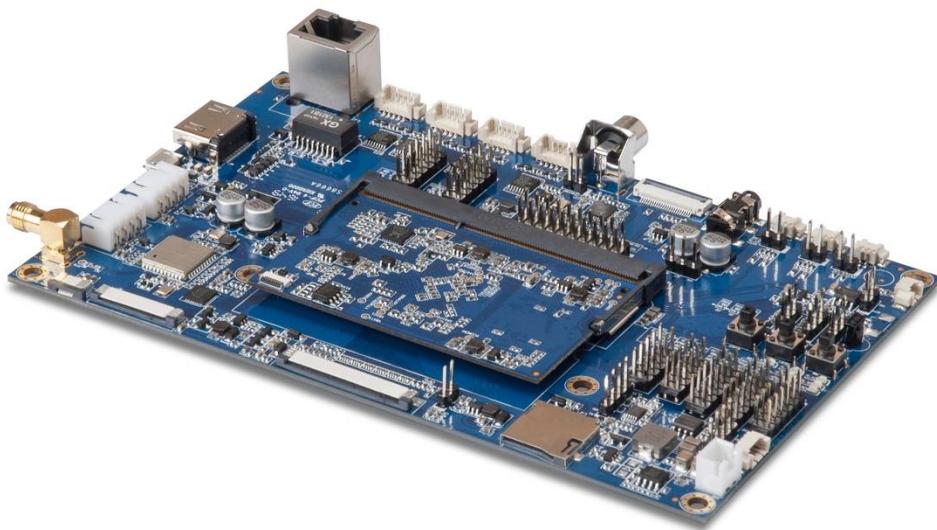
531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan  
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | [www.viatech.com](http://www.viatech.com)

### VIA、チケット発券、サイネージ、キオスク端末の自動化を実現する

### VIA SOM-6X50 IoT アクセラレーションプラットフォームを発表

—フレキシブルな超小型モジュールをEmbedded World 2017のVIAブースにて公開—

2017年3月2日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、3月1日、自動発券、サイネージ、キオスク機器の迅速な開発を可能にする、新しいVIA SOM-6X50 IoT アクセラレーションプラットフォームを発表し、販売を開始いたしました。



「消費者がスマートフォンやスクリーンをタップして、情報やアイテムの購入ができるようにするセルフサービスシステムは、小売店や駐車場だけでなく、ほかの用途においてもユーザー体験を向上させる上で非常に重要です」とVIA国際マーケティング担当VPのリチャード・ブラウンは説明します。「最新のVIA SOM-6X50 IoT アクセラレーションプラットフォームを活用すれば、オペレータは正確な導入ニーズを満たす自動情報ディスプレイおよびトランザクション処理システムを設計・構築することができます」。

VIA SOM-6X50 は、わずか 6.76cm x 4.3cm の超小型システムオンモジュールです。 1.0GHz VIA Cortex-A9 SoC を搭載し、幅広い IoT オートメーションおよびマン・マシン・インターフェース(HMI)アプリケーションに対応した柔軟性の高いパッケージで、すぐれたパフォーマンスと豊富なマルチメディア機能の完璧なバランスを実現します。

# VIA、チケット発券、サイネージ、キオスク端末の自動化を実現する VIA SOM-6X50 IoT アクセラレーションプラットフォームを発表

2/3

I/O およびディスプレイ拡張オプションには、USB 2.0 ポート×2、USB 2.0 デバイスポート×1、HDMI ポート×1、シングルチャネル 18/24 ビット LVDS パネル×1、CSI カメラ入力×1、10 / 100Mbps イーサネット×11、GPIO×11 1 つの SD カードスロット。VIA SOMDB1 キャリアボードのマルチ I/O 評価用キャリアボードが用意されています。特定の要件を満たすカスタムベースボードを開発することもできます。

VIA SOM-6X50 は、カーネル(3.4.5)とブートローダのソースコードを含む Linux BSP を備えています。その他の機能には、カーネルを調整し、VIA SOMDB1 キャリアボード I/O およびその他のハードウェア機能をサポートするツールチェーンが含まれています。

VIA SOM-6X50 IoT アクセラレーションプラットフォームは、ドイツ・ニュルンベルクで 3 月 14 日～16 日に開催される 2017 Embedded World Exhibition and Conference の VIA ブースに展示されます。VIA ブースは、ニュルンベルク展示場のホール 2 #2-551 です。また、VIA ブースでは、この他に、商用グレードのシステム、マン・マシン・インターフェース(HMI)スターターキット、IoT アクセラレーションプラットフォームなど、幅広いスペクトラムの展示を予定しており、車載アプリケーションや駅構内アプリケーションなどに迅速にカスタマイズすることができるソリューションをご覧いただけます。

VIA SOM-6X50 の詳細については、下記 URL を参照してください。

<https://www.viatech.com/en/boards/modules/som-6x50/>

Embedded World 2017 における VIA ブースについては、<http://www.viatech.com/jp/embedded-world-2017> をご参照ください。

VIA カスタム IoT 設計サービスの詳細については、<http://www.viatech.com/en/services/hw-engineering/arm/custom-design/> をご参照ください。

本リリースに関連する画像については、<http://www.viagallery.com/som-6x50/> をご覧ください。

## VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットホームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

## お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: [mktjp@viatech.co.jp](mailto:mktjp@viatech.co.jp)

VIA、チケット発券、サイネージ、キオスク端末の自動化を実現する  
VIA SOM-6X50 IoT アクセラレーションプラットフォームを発表

3/3

**本件に関する報道関係者からのお問い合わせ**

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : [RIBrown@via.com.tw](mailto:RIBrown@via.com.tw)

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : [press@hanare-pr.jp](mailto:press@hanare-pr.jp)

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。